

**雷尼绍宣布推出适用于REVO®多传感器系统的全新非接触式影像测头**

雷尼绍隆重地宣布推出全新影像测头 (RVP)，以在坐标测量机 (CMM) 上与REVO五轴测量系统配用。RVP通过将非接触式检测功能添加至该系统现有的触发式、高速接触式扫描和表面粗糙度测量功能中，来增强REVO的多传感器功能。

就某些应用而言，非接触式检测技术明显优于传统的接触式测头测量技术。对于具有大量小至0.5 mm的孔的薄板金属工件或组件以及不适合接触式测量的工件，可以利用RVP系统进行全面检测。RVP同时还利用REVO测座提供的五轴运动和无级定位来显著提高测量效率和坐标测量机功能。

RVP系统包括测头和一系列模块，可自动与REVO的所有其他测头选件互换。多个传感器采集的数据自动参照同一基准。这一灵活性意味着可选择最合适的传感器在同一坐标测量机平台上检测多种特征。

使用RVP时，每个模块内部集成的程控LED灯光可为工件提供照明。在采用配有背光照明的定制工件夹具时，还可使用背景特征增强功能。

RVP系统使用与REVO相同的符合I++ DME标准的界面来管理，由雷尼绍MODUS™测量软件提供所有用户功能。全新MODUS影像仪软件功能包括RVP配置、含有应用特定选项的图像处理以及自动图像存储，这些功能可供查看和进一步分析之用。

2015年10月5日-10日意大利米兰2015欧洲机床展期间，来宾可光临5号馆D15展台，观看雷尼绍全新RVP系统现场演示。

详情请访问www.renishaw.com.cn/cmm。

完